

【東京/武蔵村山】半導体新装置開発 / 組み込みソフトエンジニア半導体　◆ヤマハ発動機グループ

ヤマハロボティクス株式会社での募集です。 組み込み・制御系のご経験のある方は歓...

Job Information

Recruiter
JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company
ヤマハロボティクス株式会社

Job ID
1594515

Industry
Electronics, Semiconductor

Job Type
Permanent Full-time

Location
Tokyo - Other Areas

Salary
4.5 million yen ~ 7.5 million yen

Work Hours
08:45 ~ 17:30

Holidays
【有給休暇】有給休暇は入社後4ヶ月目から付与されます 初年度 採用月に応じて2日～15日 4か月目から 【休日】完全週休二日制…

Refreshed
November 1st, 2026 00:00

General Requirements

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
None

Minimum Japanese Level
Native Level

Minimum Education Level
Technical/Vocational College

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2335250】
【仕事内容】

半導体製造装置のソフト開発において、新機種開発プロジェクトや現行機のカスタマイズ案件にアサインします。OJTもつけて育成しますので、ご安心ください。画像処理にも興味があれば学べる環境です。

■魅力
対峙するのは世界トップの半導体メーカーです。半導体は最先端であり日々進化することや、超微細なモノづくりのための

装置ですので、技術面で奥深さがあります。
同事業所内に、機械・電気の担当者も所属しているため、新機種開発においてプロジェクトを組んで、思った通りに機械が動いた時の喜びを皆で味わいモノづくりをしていきます。半導体製造装置（ボンディング装置）メーカーである当社において、ソフト設計業務をお任せいたします。

★半導体ボンディング装置のパイオニア企業です★
1970年代後半、それまで人の手で行われていたワイヤボンディング（半導体製造における後工程作業）の全自動化に成功したのは当社です。競合が増えた今、当社の強みは品質No.1であり仕様に沿ってカスタマイズ設計ができること。この丁寧さは今後も捨てずに、日本企業としての自信・自負をもって世界No.1であり続けるのが私たちの目標です。

[取扱い製品】
ワイヤボンダ、ダイボンダ、バンプボンダ、フリップチップボンダ、等

□主力製品「フリップチップボンダ」について
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

半導体製造のための精密ロボットです。
ウェハー上に形成された半導体素子を、反転（フリップ）させて基板上
もしくはウェハー上へボンディングする為の装置で、従来のワイヤボンディングに
替わる新しい実装技術になります。
最新のスマートフォンやデータセンタの中心的な役割を果たすICを
製造する為の装置です。
メカトロニクス技術はもちろん、制振制御、ロボティクス、材料工学、
画像処理技術などあらゆる最先端の技術がつまっています。

Required Skills

■必須条件：
C、C++でのPG経験（学習経験でも可）

■歓迎条件：
半導体製造装置、表面実装機、外観検査装置等のソフト開発経験

Company Description

ヤマハロボティクス株式会社（Yamaha Robotics Co. Ltd.）は、ヤマハ発動機株式会社グループにおいて半導体製造装置（後工程）および電子部品組み立て装置事業を担う会社です。